

2015年4月27日

三菱化学が SUNY Poly と次世代の半導体向け CMP 後洗浄剤の開発を目的とした
評価委託契約に合意

三菱化学株式会社

三菱化学株式会社（本社:東京都千代田区、社長：石塚博昭、以下「当社」）は、世界をリードする最先端研究教育機関である米国ニューヨーク州立ポリテクニク・インスティテュート（SUNY Polytechnic Institute、以下「SUNY Poly」）（*1）と、次世代半導体の製造における CMP（化学機械的研磨）工程（*2）に使用される洗浄剤に関する評価委託契約を締結しましたので、お知らせいたします。

併せて、SUNY Poly および世界の主要半導体メーカーが参加するコンソーシアムであるセマテック（SEMATEC : Semiconductor Manufacturing Technology）が運営する、次世代 CMP 工程および材料を開発する CMP センター（Chemical Mechanical Planarization Center）へ参画することとなりました。

当社は、半導体製造工程および液晶パネル・太陽電池などの電子デバイスの製造工程で使用される各種 EL 薬品（電子工業用薬品）の製造・販売を 1981 年より行っており、1996 年には台湾における製造・販売拠点を設置するなど、ビジネスを拡大してまいりました。

近年、半導体は、その高性能化・低消費電力化に向け、さらなる微細化が進んでおり、製造工程の一つである銅配線形成後の CMP 後洗浄工程においては、基板への腐食やダメージを与えずに、銅配線や絶縁膜上に残留する有機残渣やパーティクル、金属不純物等を除去する技術がこれまで以上に強く求められてきております。

このたびの評価委託契約および CMP センターへの参画により、同センターが保有する世界最高水準の半導体装置・技術を活用し、10nm、7nm といったテクノロジーノードの次世代半導体に対応可能な CMP 後洗浄剤の開発・評価が可能となります。

当社は、本契約を始めとして SUNY Poly との関係を構築し、世界的に競争力のある CMP 後洗浄剤を開発・上市してまいります。

*1 SUNY Polytechnic Institute

SUNY Poly は、2 つのニューヨーク州立カレッジである、SUNY ナノスケール理工学カレッジ（CNSE: College of Nanoscale Science and Engineering）と SUNY テクノロジー・カレッジ（SUNY IT: SUNY Institute of Technology）が合併し、ニューヨーク州立大学内に設立されました。

SUNY Poly は、世界をリードする最先端研究教育機関として、これまでに 200 億ドル以上のハイテク分野への投資を行い、300 以上の企業パートナーと提携し、ニューヨーク州内各地に研究拠点を拡大し続けています。

URL: <http://www.sunycnse.com/>

URL: <https://sunypoly.edu/>

*2 CMP 工程

Chemical Mechanical Planarization（またはPolishing）の略で、半導体デバイスプロセスにおいて、基板表面の凹凸を平坦化する研磨加工をCMPという。砥粒などの粒子による機械的な除去作用と薬液による溶去作用を組み合わせた研磨方法。シリカやアルミナなどの微粒子をアルカリ性あるいは酸性の化学的水溶液に混合、分散させた研磨剤と研磨パッドが使用される。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

(株)三菱ケミカルホールディングス 広報・IR 室

TEL : 03-6748-7140